

6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ

伊藤 光昌 (イトウ ミツマサ)

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ会長

軽量化と高トルク化を実現した新製品を市場投入

◆決算の概要

常務 長井 啓

2013年3月期第2四半期の連結売上高は、5月15日に発表した期初予想に対して0.5%の未達となったが、概ね予想の範囲で着地した。一方、営業利益は期初予想を上回っており、これは単体の限界利益率が想定をやや上回ったことが要因である。

前年度実績と比較すると、過去最高の売上高であった前年同期比では11.3%の減収となった。利益面では、減収に伴い営業利益も減少したが、当社の利益体質を前提とすれば、減益幅は小さかった。これは、前年同期比でプロダクトミックスがプラスに働いたことに加え、前年同期に発生した工場の増築やレイアウト変更などに関わる一過性コストが当期は無かったことなどによるものである。経常利益については、持分法適用関連会社2社の収益が落ち込み、持分法投資損失を計上したため、営業利益よりも減益幅が大きくなった。

主要グループ会社の状況については、米国子会社のハーモニック・ドライブ・エルエルシーでは、半導体製造装置向けの需要が軟調となったことに加え、米国政府の予算縮小を受けて航空・宇宙向けの需要も減少し、減収を余儀なくされた。円高・ドル安の影響を受けて営業利益も減益となったが、税金費用が少なかったこともあり四半期純利益は前年同期比で増益となった。精密遊星減速機を製造しているハーモニック・エイディでは、モーターメーカー向けギアヘッドの需要が低調となり、売上高が前年同期比21.6%減となった。利益面についても、減収による影響などにより四半期純利益が35.3%減少した。持分法適用関連会社のハーモニック・ドライブ・アーゲーでは、欧州経済が低迷する中、工作機械向け、航空・宇宙関連の売上が減少した影響を受け減収減益となった。

◆半導体製造装置の受注がスローダウン

用途別の単体売上高については、半導体製造装置向けは、昨年末以降、微細化投資をベースに堅調な需要動向が続いていたが、夏場にかけて受注がスローダウンした。FPD製造装置向けについては、一部で5.5Gの投資が行われたものの、韓国パネルメーカーの大型設備投資が延期になっている影響を受け低い水準で推移している。産業用ロボット向けは、夏場以降、小型組立ロボットの需要が軟調となったが、自動車産業で多く使われる溶接ロボット向けが堅調に推移したことから、概ね期初予想通りの実績となった。

前年同期比で単体営業利益が減少した要因としては、減収の影響が7億37百万円、販管費の増加が16百万円である。一方、改善要因としては、限界利益率の影響が1億60百万円となっており、これは利益率が相対的に劣後する大型製品の売上高比率の低下や原価低減活動の効果などによる。また、製造固定費は1億43百万円減少した。これは前年同期に発生した工場のレイアウト変更などによる一過性のコストがなくなった影響によるものである。また、設備投資が功を奏し、残業代なども減少している。

連結の資産状況としては、営業活動による収入増で現預金が増加した。前期に50億円の長期資金の借入を実施したことから手元現金は高い水準にあり、安定した経営を継続する資金を確保している。投資その他の資産の

減少は、政策保有している上場会社株式の時価変動が要因である。負債・純資産の部では、利益剰余金が増加したことにより純資産が増加した。

連結キャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比で大幅に増加しているが、前年同期は法人税の支払い額が大きく、低水準であったことによるものである。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の減少、定期預金が満期になったことに伴う収入などにより大幅な増加となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済額が増加したため支出が増加した。以上の結果、現金および現金同等物の四半期末残高は 83 億 53 百万円となった。

◆通期の連結業績予想を下方修正

通期の連結業績予想については、第 2 四半期決算発表と同時に期初予想を下方修正した。これは、夏場以降の受注減少と足元の受注水準を勘案し、下期の売上高予想を修正したことが主な要因であり、売上高を 19 億円、営業利益を 8 億 80 百万円下方修正した。なお、受注がさらに底割れするとは見ておらず、10 月で底を打った印象を持っている。

業績予想を下方修正したことに伴い、当期の業績は、前年同期比で減収減益となる見込みである。下期の連結売上高は、上期比 12.1%減の 86 億 80 百万円を見込んでおり、通期では 185 億円となる見込みである。営業利益については、生産量の減少に伴って残業代や電気料金などは減少するものの、減価償却費の増加などにより、減収の影響を補うまでには至らず、前期比 18.8%減の 35 億 20 百万円を予想している。

主要グループ会社のうち、ハーモニック・ドライブ・エルエルシーについては、引き続き半導体関連が低調となっており、為替がやや円安に動いているものの、コストを大幅に改善するほどには至っていないため、通期でも減収減益を見込んでいる。ハーモニック・エイディは、当面、モーターメーカー向けギアヘッドが低調に推移すると見ているが、航空機用途向けは比較的堅調であり、工作機械も安定した需要を見込んでいる。利益面では、経営改革の効果が着実に表れており、今後も売上だけではなく、収益力を重視して事業を強化していく。ハーモニック・ドライブ・アーゲーは、欧州域内の経済低迷により減収減益となる見込みである。

当社単体の受注動向としては、足元では全体的にお客様における在庫調整の影響を受けているが、年明けからは徐々に回復すると見ている。下期の売上高見通しとしては、半導体製造装置向けは引き続き低調を予想しているが、Windows8 の効果で NAND 型フラッシュメモリが増加していることや、スマートフォンの需要も拡大していることから、早ければ第 3 四半期から回復に向かうと見ている。FPD 製造装置向けについても、一部のお客様から中小型パネル案件に関連した引合いが増加傾向にあることから、年明け以降、具体的な動きが出てくるものと見込んでいる。産業用ロボット向けも、中国での設備投資抑制の影響を受け、生産及び在庫調整が継続しており、足元の受注状況に力強さは無いが、年明け以降これらの調整が完了し、緩やかに増加に転ずるものと見込んでいる。

単体営業利益は、限界利益率等の変化が 2 億 10 百万円、製造固定費・その他費用の減少が 1 億 90 百万円の改善効果を予想しているものの、減収の影響を 8 億 48 百万円、販管費の増加に影響を 78 百万円見込んでいることにより、前期比で減益を予想している。

◆今後の展望

会長 伊藤光昌

当社グループは現在、業績の踊り場を迎えている。これは、設備投資の動向に依存している我々にとって、創業以来繰り返してきた短期的な需要サイクルの綾にすぎないものと考えているが、一方で大きな変化が起こっているのではないかと感じている。国内においては、エレクトロニクス企業の競争激化とそれに伴う国内メーカーの苦戦、円高などにより弱体化する国内製造業の産業基盤、さらには停滞する政治など、不安要素が多くある。しか

し、日本がモノづくりに強いことに変わりはなく、当社グループとしても、模倣困難な技術と技能の蓄積によって、モノづくり企業として生き抜いていきたいと考えている。

中期的な成長の鍵は、品質と安全を最優先した経営、コア技術の強化、製品バリエーションの拡充、アジア地域への拡販強化である。アジア地域においては、中国問題の影響が懸念されているが、当社グループは日中関係悪化の直接的な影響を受けておらず、中国上海市に新設した販売子会社の技術サポート力が評価され、中国で展開する欧州企業や地元のロボットメーカーからの受注獲得など、明るい報告が届いている。一時的に減速しても、アジアが有望な市場であることに変わりはなく、今後も拡販強化に努めていきたい。

当社グループは創業以来、地道で継続的な研究開発によって基本性能の向上を図ってきた。また、減速機の性能を最大限に引き出し、使い勝手を良くするための周辺部品も開発し、これらを高度に組み合わせることによって新たな市場を切り開いている。今後も減速機本体の優位性向上を図り、周辺部品を高度に無駄なく組み合わせることで製品のバリエーションを強化していきたい。

当期の新製品「軽量ハーモニックドライブ®」では、設計の工夫と新材料の採用などにより、既存製品のトルク容量を維持しながら 20～30%の軽量化を実現した。従来用途におけるトータル・モーション・コントロールの高度化に寄与するだけでなく、新製品・新用途開発を可能にするものと期待している。「高トルク遊星減速機」では、従来製品の重量や外形寸法を維持しながら約 33%のトルクアップに成功した。当社グループは高精度遊星減速機のカテゴリーでトップシェアを持っているが、本製品の市場投入により更なる拡大を図っていく。

減速機の軽量化は、ロボットの高速度・可搬重量の増加につながり性能の向上に寄与する。産業用ロボットでは、用途の広がりとともに、多様なニーズへの対応、更なる基本性能の向上が求められているが、このようなニーズは今後増加が見込まれる革新的技術を持った省力化高性能機械装置にも不可欠になると確信しており、新たな用途の開拓につなげていきたい。なお、大きな技術革新には 5～10 年の時間を要するが、今後は開発スピードの短縮が大きな課題となる。基礎理論研究、材料開発、生産技術開発、耐久試験などを繰り返し、着実に技術と技能の蓄積を進めていきたい。

(平成 24 年 11 月 21 日・東京)

* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

<http://www.hds.co.jp/ir/event/accounts/>